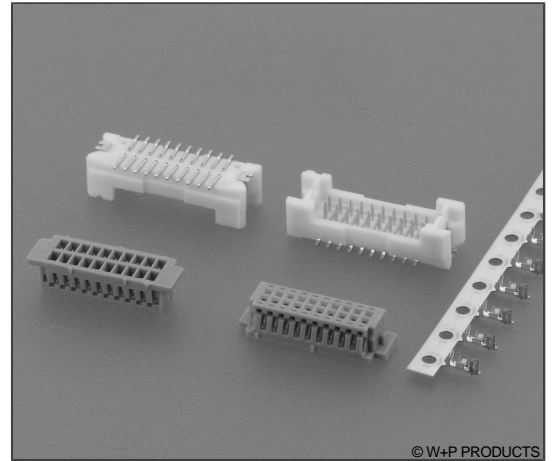


## SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,25mm, stehend, 2-reihig SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.25mm Pitch, Vertical, Double Row

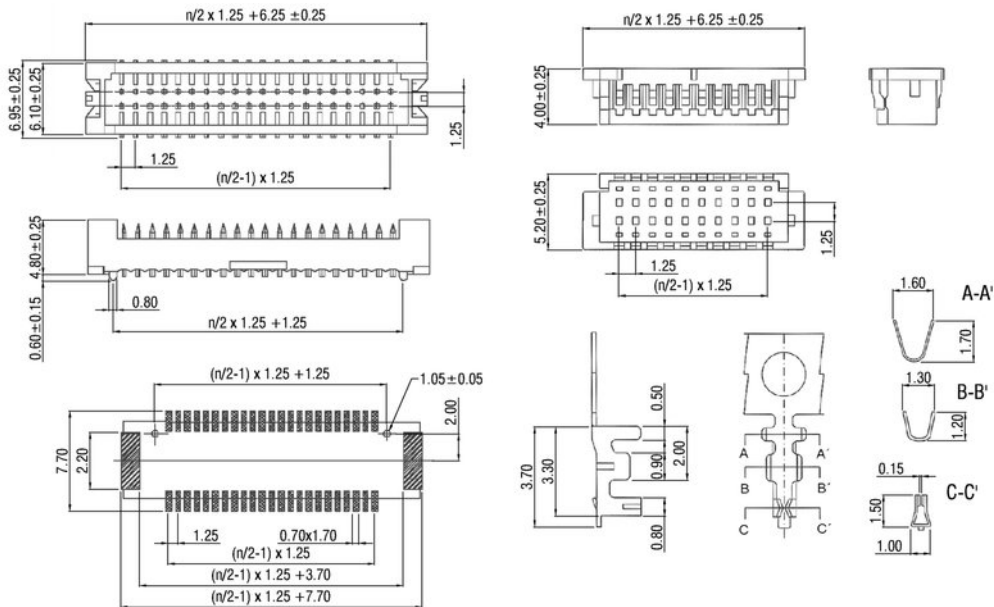
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 32 ~ 28
Applicable wire Gauge	AWG 32 ~ 28
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 500MΩ
Insulation Resistance	> 500MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
Test Voltage	500V <sub>AC</sub>
Nennspannung	100V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	100V <sub>AC</sub>
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

In weiß und beige erhältlich.  
Available in white and beige.



<b>Series</b> <b>1250</b>	<b>Contacts*</b> <b>20</b> 10 20 30 40	<b>Type</b> <b>10</b> 10 Wannenstecker Box header	<b>Plating*</b> <b>00</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated	<b>Packing</b> <b>PPTR</b> PPTR Tape & Reel mit Pick&Place-Pads Tape & Reel with Pick&Place-Pads
<b>Series</b> <b>1250</b>	<b>Contacts*</b> <b>20</b> 10 20 30 40	<b>Type</b> <b>20</b> 20 Crimp-Gehäuse Crimp Housing	<b>Packing</b> <b>00</b> 00 Schüttgut Bulk good	
<b>Series</b> <b>1250</b>	<b>Contacts</b> <b>01</b>	<b>Type</b> <b>30</b> 30 Crimp-Kontakte AWG28-32 Crimp terminals AWG28-32	<b>Plating*</b> <b>50</b> 00 Vergoldet Gold plated 50 Verzinkt Tin plated	

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

